



2018年3月期 決算説明会

2018年5月14日

TOWA株式会社

本日の主な説明内容

- 1. 2018年3月期 実績**
- 2. 2019年3月期 予想**
- 3. 2019年3月期 取り組み**

本日の主な説明内容

- 1. 2018年3月期 実績**
2. 2019年3月期 予想
3. 2019年3月期 取り組み

2018年 3月期 連結業績結果（前年比）

（単位：億円）

	2017/3期 実績	当初計画	修正予想 (11/6修正公表)	2018/3期 実績	前年比
売上高	276.3	295.0	306.0	310.1	+ 12.2%
営業利益	38.3	40.0	44.9	36.8	▲ 3.9%
経常利益	41.3	41.5	45.2	35.4	▲ 14.3%
当期純利益	38.6	28.5	30.5	30.2	▲ 21.7%

※ 当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2018年 3月期 サマリー

受注・売上

- スマートフォンのメモリー搭載容量増加やデータセンターの増設などにより、DRAM・NAND型フラッシュメモリーの需要が増加
- IoT、AI、電気自動車、第5世代移動通信（5G）などによる半導体用途の広がり
- 膨大な計算を高速処理する高性能な仮想通貨用半導体需要の高まり
- 中国市場において半導体後工程の世界トップとなる規模の設備投資

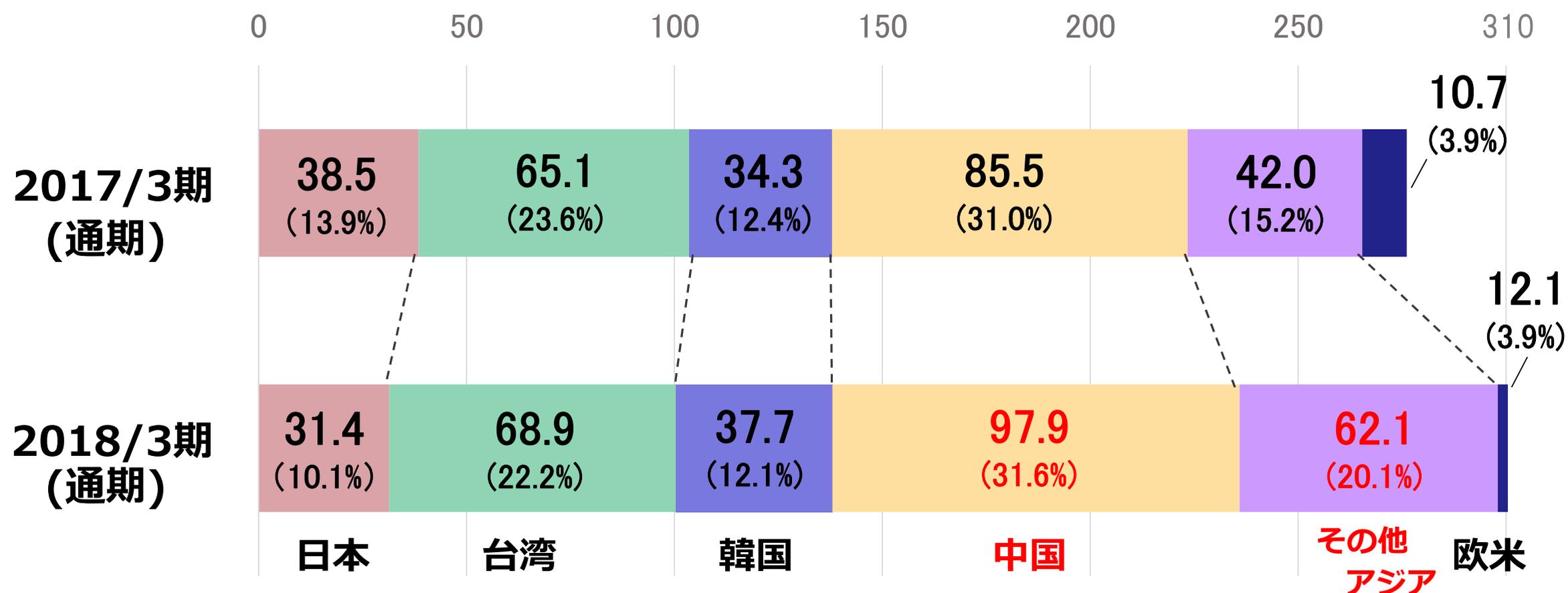


中国市場を軸に受注・売上高は高水準で推移

2018年 3月期 地域別売上高（仕向地ベース）

中国・その他アジア向け売上が伸張

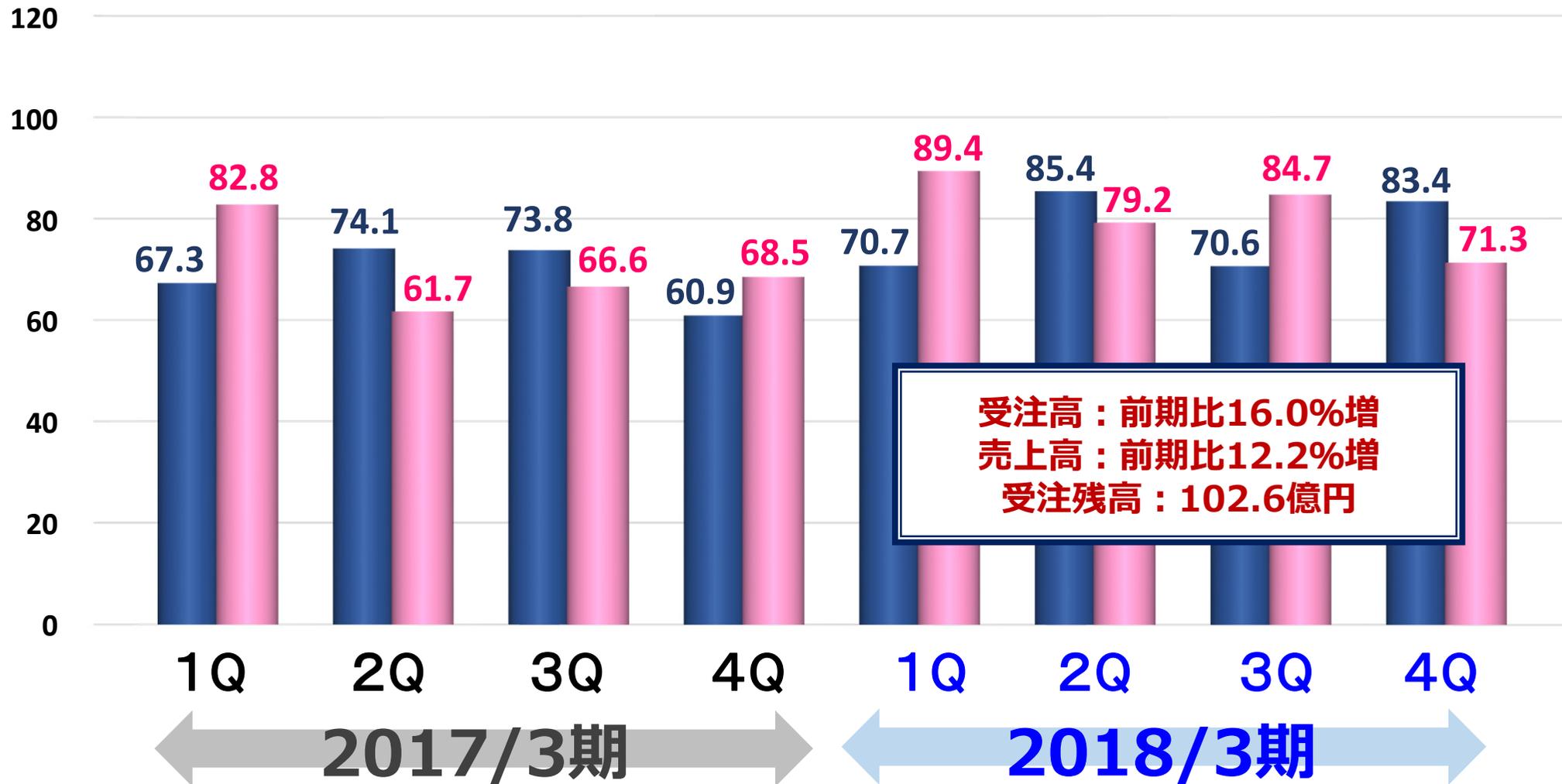
（単位：億円）



受注・売上高の四半期推移

■ 売上高 ■ 受注高

(単位：億円)



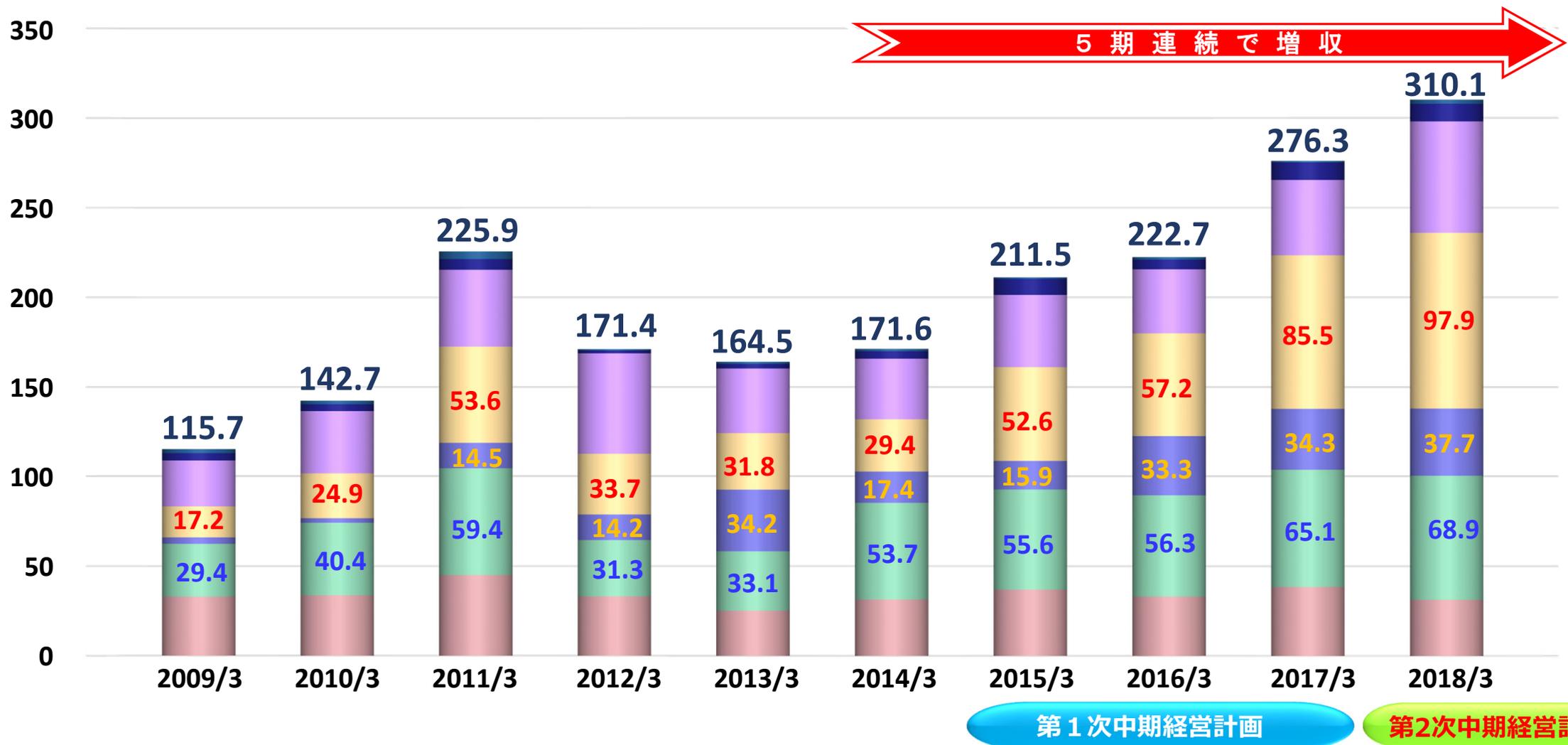
2018年 3月期 セグメント別売上高

(単位：億円)

	2017/3期 実績	2018/3期 実績	増減額	前年比
売上高	276.3	310.1	+ 33.8	+ 12.2%
半導体事業	226.0	252.8	+ 26.8	+ 11.8%
化成品事業	12.5	14.3	+ 1.8	+ 14.5%
新事業	37.8	43.0	+ 5.2	+ 13.7%

売上高の推移

■ 日本
 ■ 台湾
 ■ 韓国
 ■ 中国
 ■ その他アジア
 ■ 米州
 ■ 欧州
 (単位：億円)



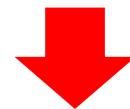
第1次中期経営計画

第2次中期経営計画

2018年 3月期 サマリー

営業利益

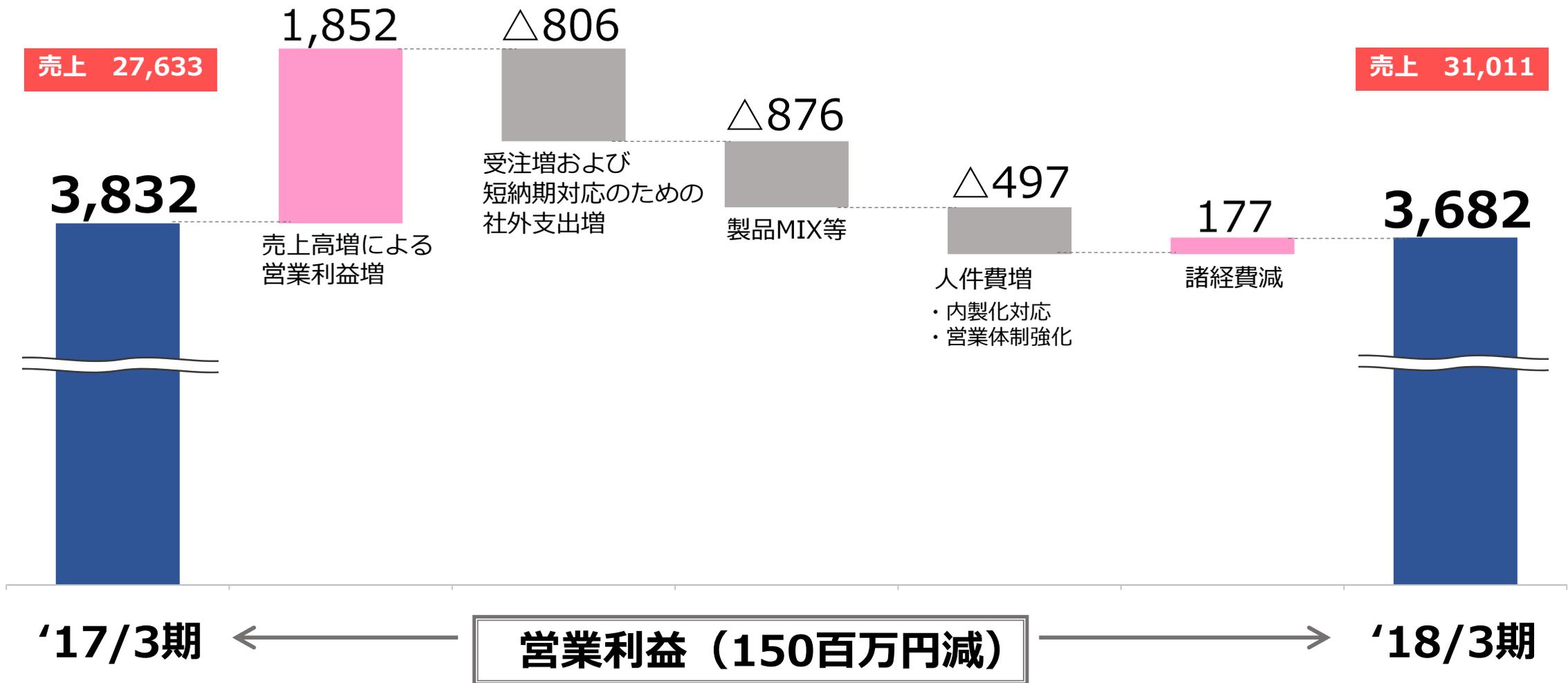
- 受注、売上高の増加や短納期対応による社外支出の増加
- 下期のコンプレッション装置比率が低下
- シンギュレーション装置の売上増による利益率の減少
- 中国市場における戦略製品の売上比率が増加
- 設計の自動化および海外生産子会社からの直出荷体制の構築などによる生産性の効率化投資によるコスト増



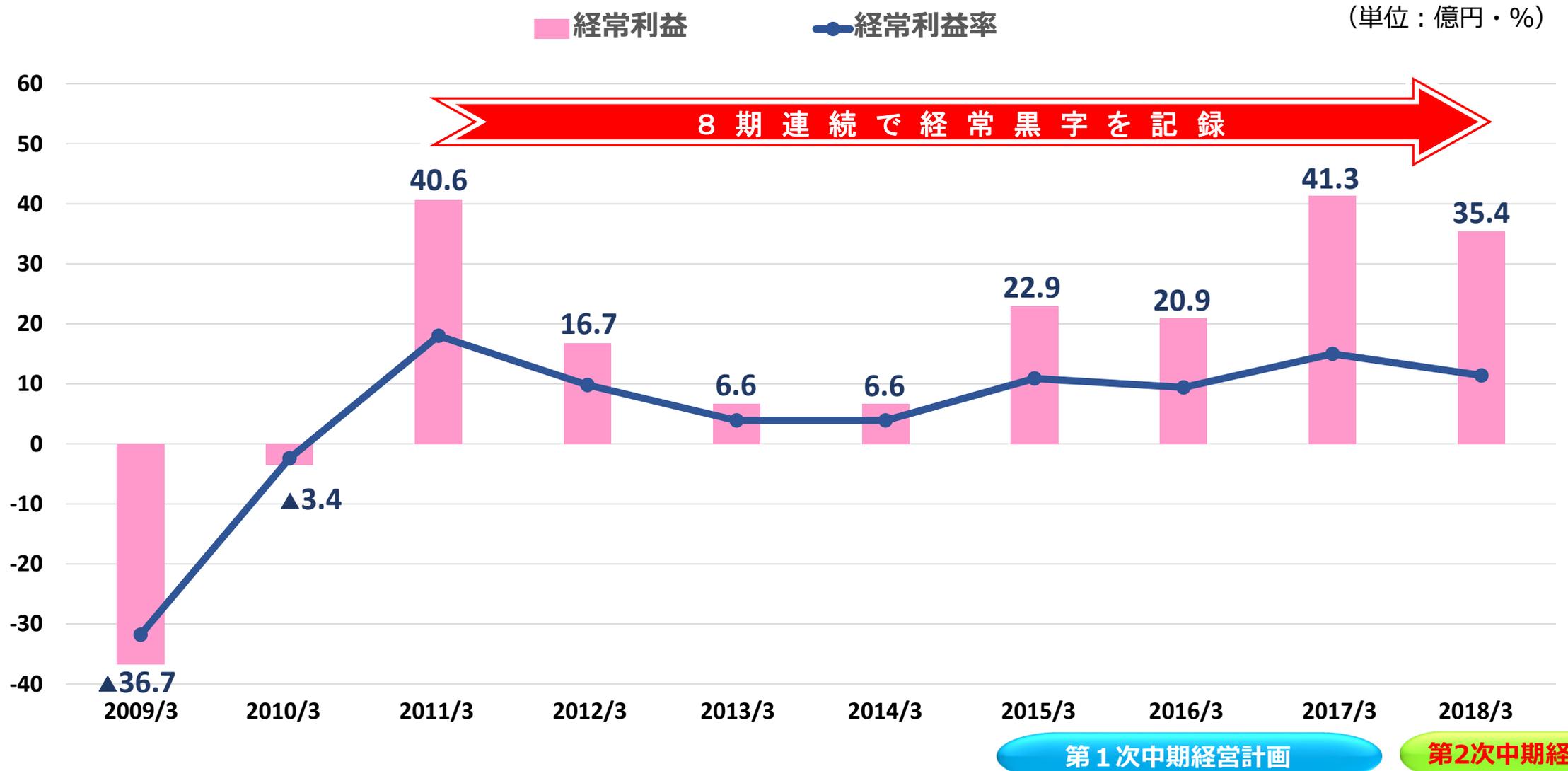
生産性の効率化により原価低減を図るが製品ミックスが主要因となり営業利益は伸び悩む

2018年 3月期 連結営業利益 増減要因分析

(単位：百万円)



経常利益の推移

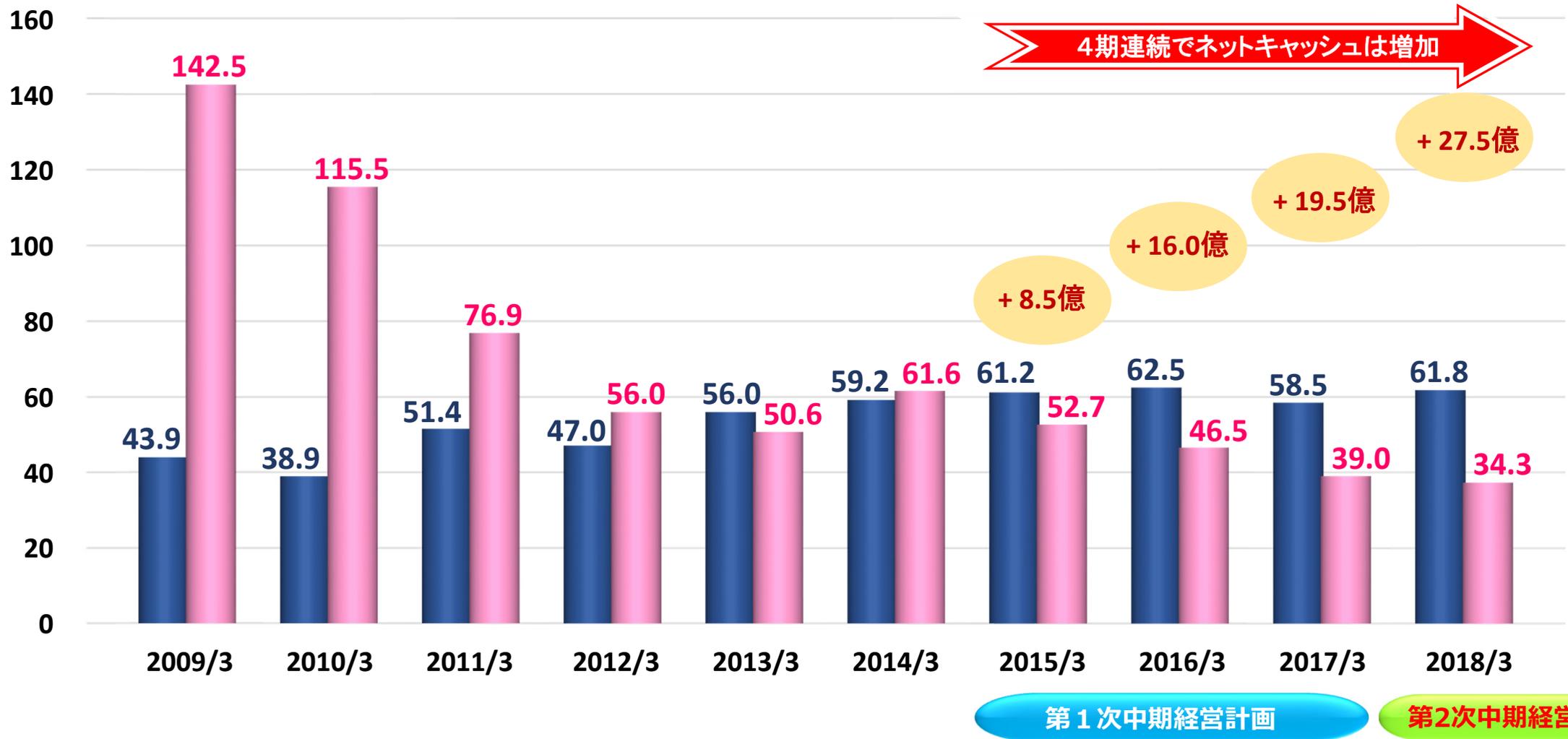


キャッシュ・フローの推移

■ 現預金残高

■ 借入金残高

(単位：億円)

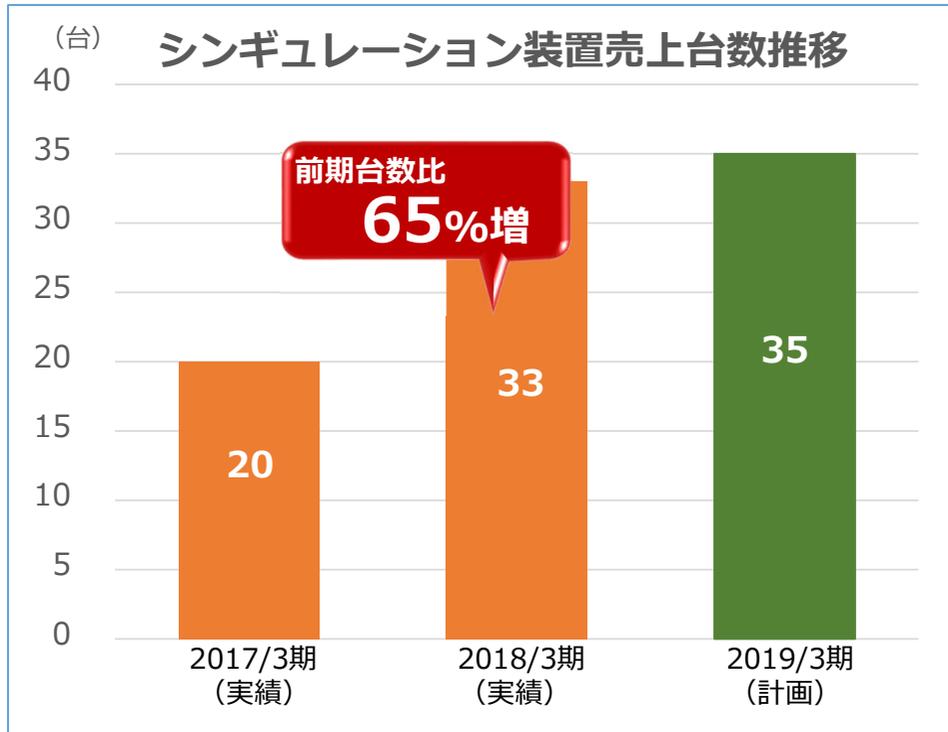


2018年 3月期 トピック

半導体事業

シンギュレーション装置の売上拡大

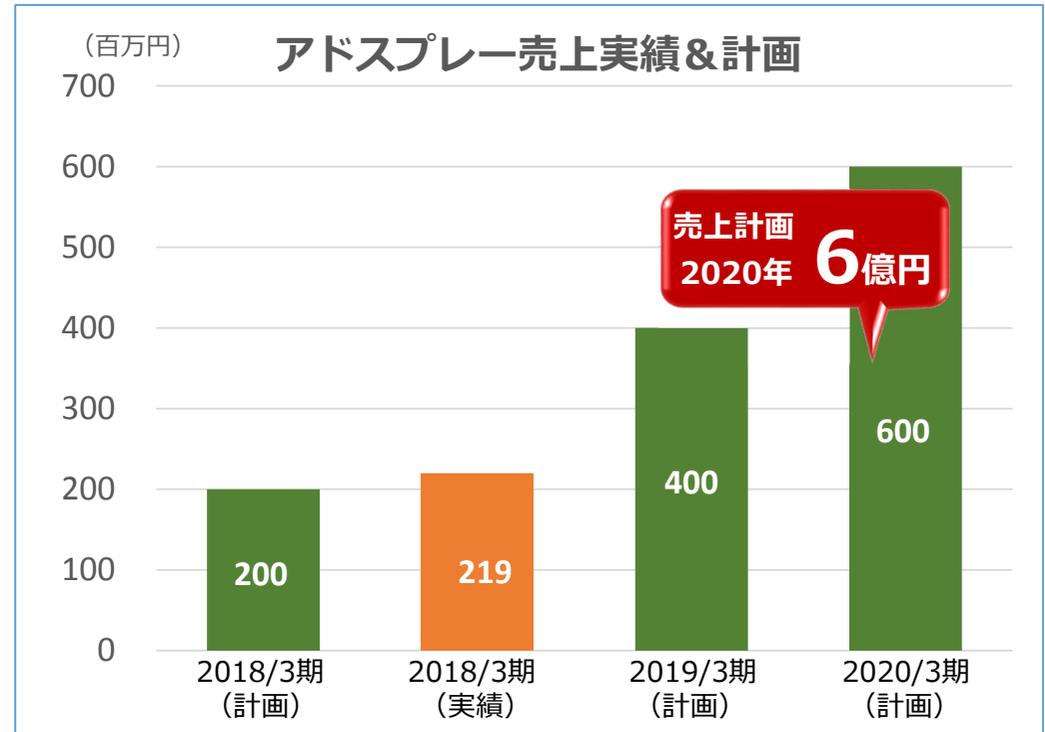
品質・生産性向上による売上拡大



化成品事業

アドスプレー売上

安定した量産体制の構築による計画達成

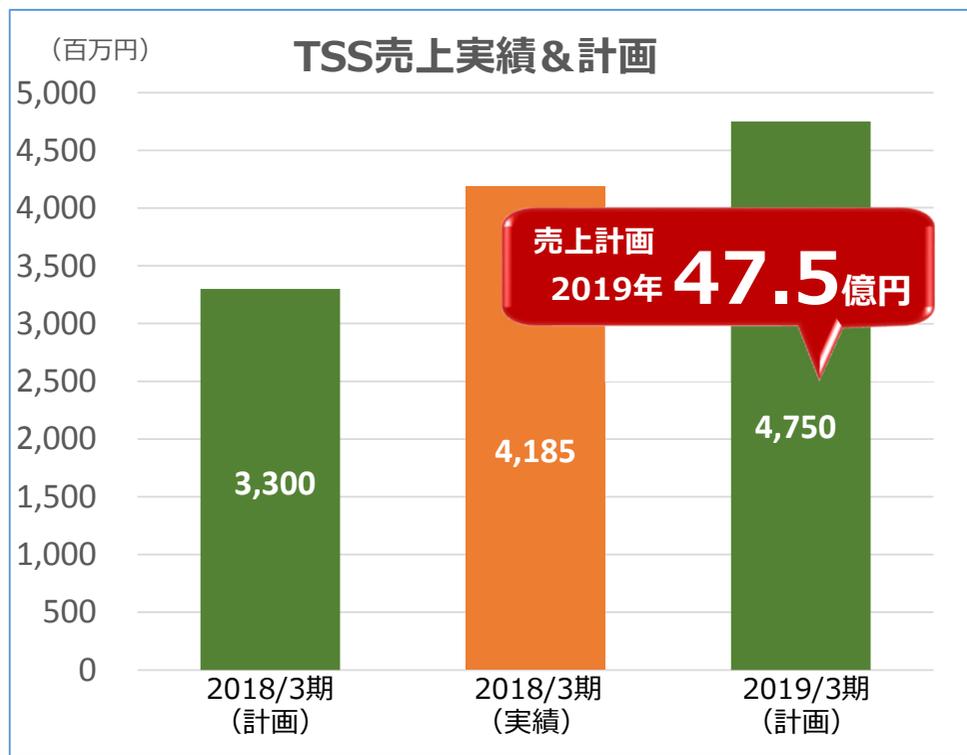


2018年 3月期 トピック

新事業

TSSの売上拡大

TOWA韓国の装置改造ビジネスによる売上拡大



新事業

新事業への積極的投資

各設備で生産能力を2~3倍増

大型EF装置

投資金額：69百万円
設備導入：2017年11月

バンセラ3号機

投資金額：1億98百万円
設備導入：2018年2月

超精密加工機

投資金額：1億円
設備導入：2018年3月

本日の主な説明内容

1. 2018年3月期 実績
2. **2019年3月期 予想**
3. 2019年3月期 取り組み

2019年 3月期 連結業績予想

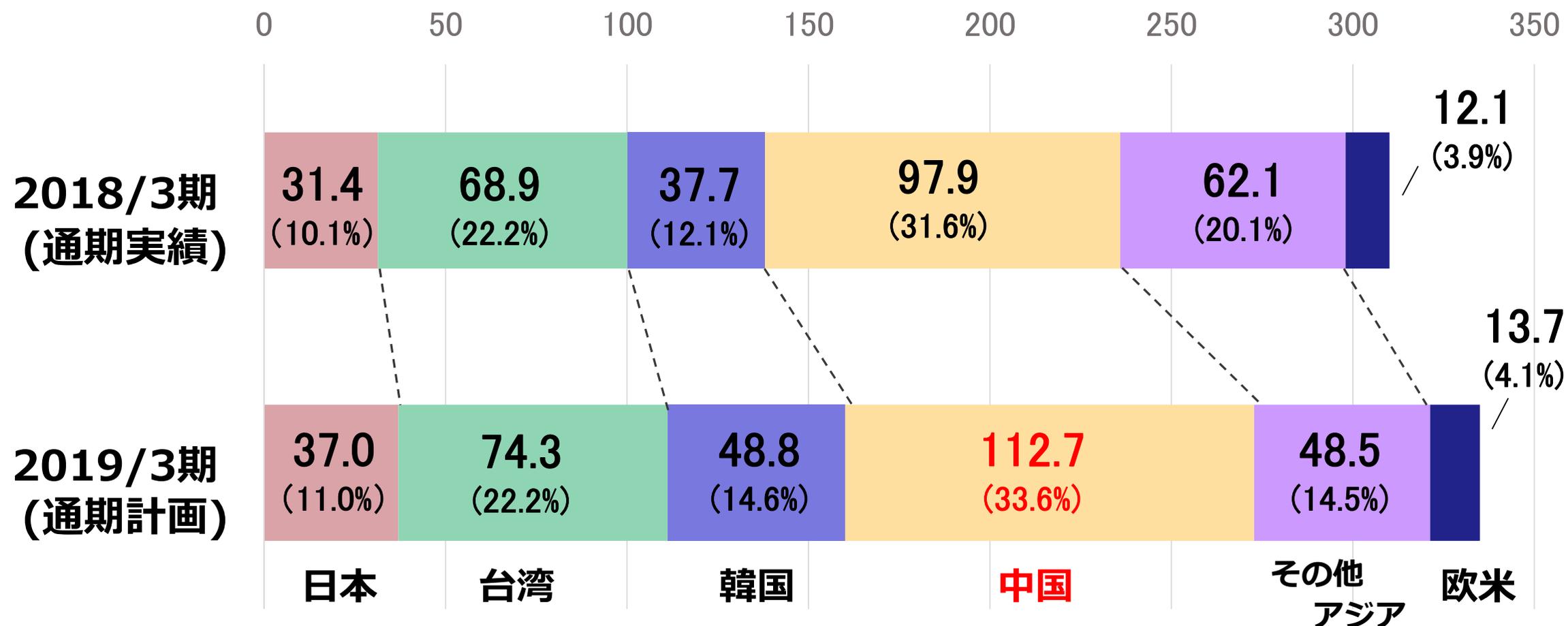
(単位：億円)

	2018/3期 実績	2019/3期 予想	増減額	前年比
売上高	310.1	335.0	+ 24.9	+ 8.0%
営業利益	36.8	40.0	+ 3.2	+ 8.6%
経常利益	35.4	40.0	+ 4.6	+ 13.0%
当期純利益	30.2	29.0	▲ 1.2	▲ 4.2%

※ 当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

2019年 3月期 地域別売上予想（仕向地ベース）

（単位：億円）



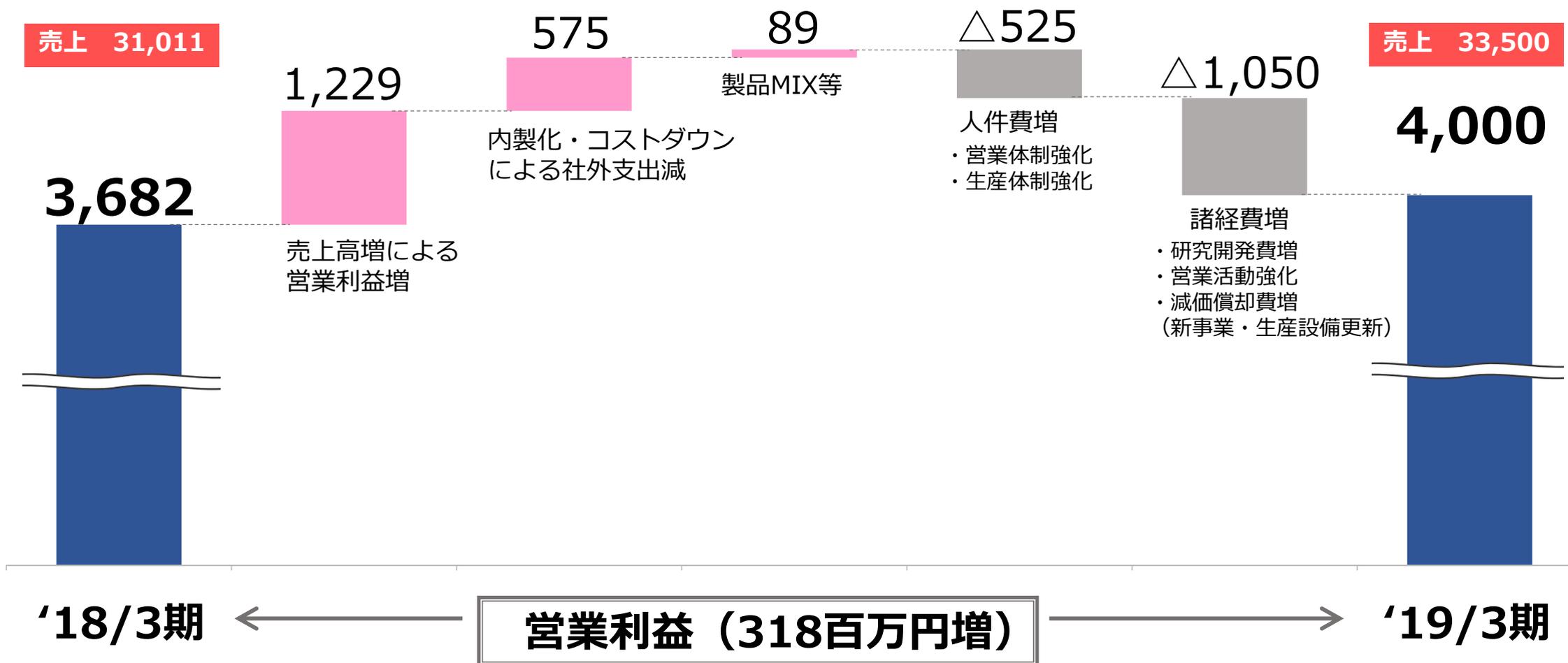
2019年 3月期 セグメント別売上予想

(単位：億円)

	2018/3期 実績	2019/3期 予想	増減額	前年比
売上高	310.1	335.0	+ 24.9	+ 8.0%
半導体事業	252.8	264.0	+ 11.2	+ 4.4%
化成品事業	14.3	15.5	+ 1.2	+ 8.2%
新事業	43.0	55.5	+ 12.5	+ 29.0%

2019年 3月期 連結営業利益予想 増減要因分析

(単位：百万円)



設備投資・配当予想

	2018/3期 実績	2019/3期 予想
設備投資	18.3 億円	26.0 億円
配 当	16.0 円	16.0 円

本日の主な説明内容

1. 2018年3月期 実績
2. 2019年3月期 予想
3. 2019年3月期 取り組み

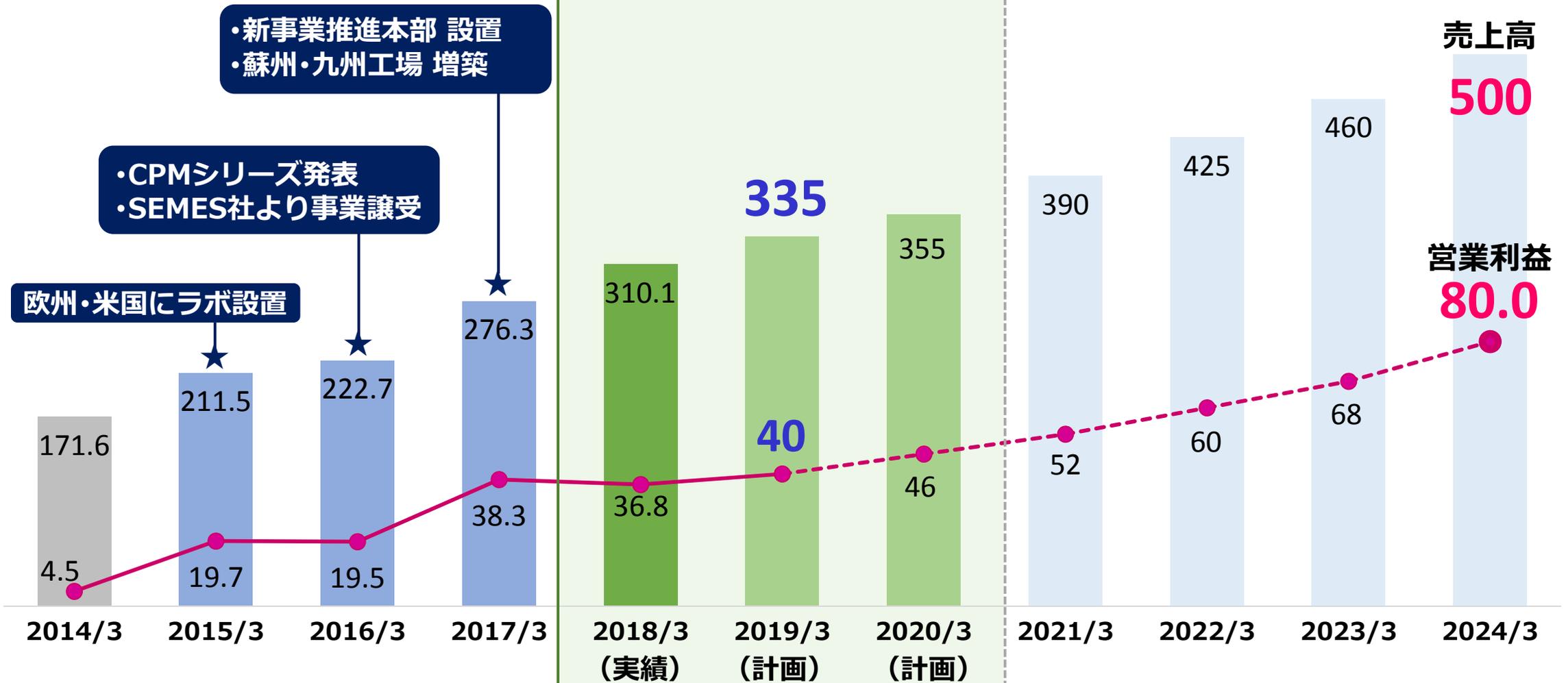
TOWA 10年ビジョン

第1次中期経営計画

第2次中期経営計画

第3次中期経営計画

(単位：億円)



2019年 3月期の取り組み

販売

- 新製品の市場投入
- WLP/PLPのシェア拡大

生産

- 製作期間短縮
- 品質・生産能力 向上

開発

- 第4次モールド革命への取り組み開始
- ゼロ・ディフェクト装置の開発

新事業

- 育成・事業化スピードの加速
- パーツ販売戦略の強化

2019年 3月期の取り組み

販売

- 新製品の市場投入
- WLP/PLPのシェア拡大

● 新製品「PMC2030-D」販売開始

- 半導体製品の厚み精度
±10 μ mを実現
- 装置内のクリーン度
Class1000を確保
- 生産性を従来機種比で
30%向上



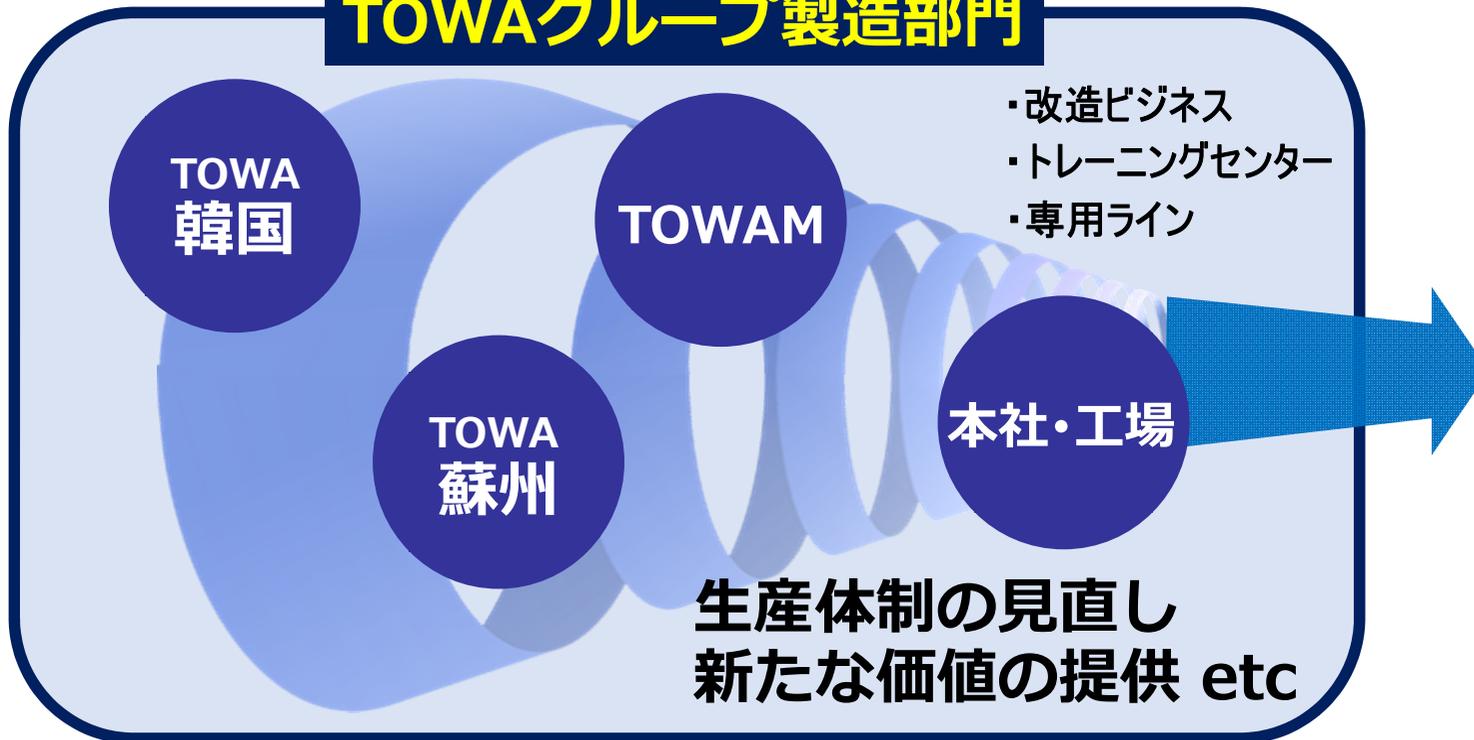
販売開始：2018年6月

2019年 3月期の取り組み

生産

- 製作期間短縮
- 品質・生産能力 向上

TOWAグループ製造部門



生産性の最大化

品質向上

スピードアップ

コストダウン

効率化

業務プロセス革新

TOWAM新工場建設計画

2019年 3月期の取り組み

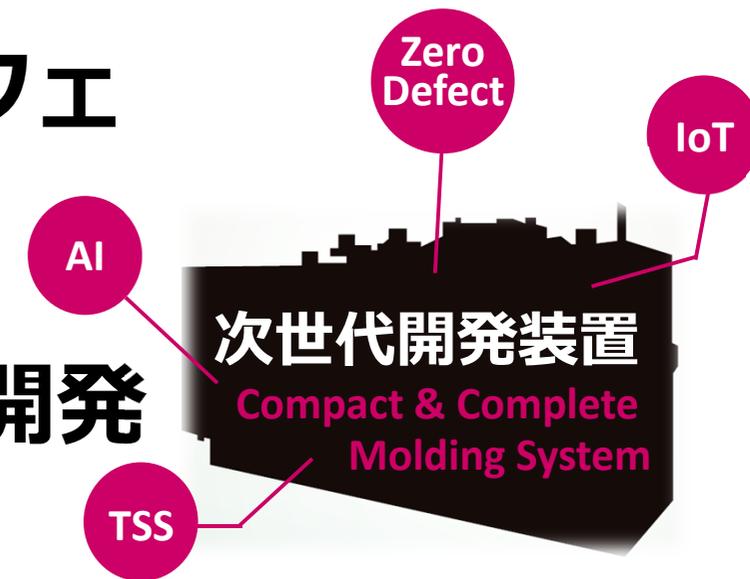
開発

- 第4次モールド革命への取り組み開始
- ゼロ・ディフェクト装置の開発

世界のモールドプロセスをTOWAに!!

● AI活用機能搭載によるゼロ・ディフェクトの達成

● 次世代半導体のモールドプロセス開発



2019年 3月期の取り組み

新事業

- 育成・事業化スピードの加速
- パーツ販売戦略の強化

メーカーとの共同開発による
最先端金属3Dプリンタと自社
製工具の融合による新事業の
創造

- $\pm 5\mu\text{m}$ の加工精度
- 硬度HRC56~57度の
材質による金型製作

投資金額：78百万円
(2018年3月28日導入済み)



2019年 3月期の取り組み

コーポレート・ガバナンスの強化による更なる 企業価値の向上



売上高200億円から
500億円企業へ！



環境の変化への
対応

法と社会倫理に
基づく行動



企業価値の向上

ステークホルダーとの
円滑な関係



株主との対話

2019年 3月期の取り組み

TOWA10年ビジョン

2014年～2024年

長期テーマ 「ものづくり企業の真価に挑む」

第2次中期経営計画

2017年～2019年

テーマ 「エンパワーメントで挑戦と飛躍を」

2018年度全社スローガン

2018年

テーマ 「超変革 TOWAの技術が世界を変える」